

【特許請求の範囲】**【請求項 1】**

複数の受光素子が配されたセンサ面と複数の入出力用リードとを有するイメージセンサと、

前記イメージセンサにおいて前記センサ面が設けられた側とは反対側の面に接するセンサ接触面を有する保持部材と、

前記保持部材における前記センサ接触面と反対側の外面に固定され、前記センサ面と平行な実装面を有し、前記実装面に垂直な方向から見たときに輪郭線の少なくとも一部が前記保持部材の輪郭線の内側に位置する回路基板と、

前記回路基板において前記実装面と交差して形成された側面上であって前記回路基板の輪郭線が前記保持部材の輪郭線の内側に位置している領域内に配された接点部と、

を備え、

前記保持部材と前記回路基板との少なくともいずれかは、前記接点部が電氣的に接続されているとともに前記入出力用リードの少なくとも一つが電氣的に接続された中継配線部を有している

ことを特徴とする撮像機構。

【請求項 2】

請求項 1 に記載の撮像機構であって、

前記接点部には、前記イメージセンサに対して電力若しくは電気信号を伝送するための第一配線が接続され、

前記側面のうち前記接点部が配された面とは異なる面上には、前記入出力用リードの少なくとも他の一つが接続され且つ前記イメージセンサに対して電力若しくは電気信号を伝送するための第二配線が接続される第二接点部が設けられており、

前記第一配線のうちの少なくとも一つは前記第二配線よりも外径が太い

ことを特徴とする撮像機構。

【請求項 3】

請求項 1 に記載の撮像機構であって、

前記側面のうち前記接点部が配された面とは異なる面上には、前記入出力用リードの少なくとも他の一つが接続され且つ前記イメージセンサに対して電力若しくは電気信号を伝送するための第二配線が接続される第二接点部が設けられており、

前記領域内には、前記接点部と異なる第三接点部が配され、

前記第三接点部は、前記回路基板に設けられた導体パターンと接続され、前記回路基板上に実装された電子部品と電氣的に接続され、

前記第三接点部には、前記電子部品と前記イメージセンサとの少なくともいずれかに対して電力若しくは電気信号を伝送するための第三配線が電氣的且つ機械的に接続される、

ことを特徴とする撮像機構。

【請求項 4】

請求項 3 に記載の撮像機構であって、

前記第三接点部は 1 つ以上設けられており、

前記第三接点部に接続された前記第三配線のうちの少なくとも一つは前記第二配線よりも外径が太い

ことを特徴とする撮像機構。

【請求項 5】

請求項 1 に記載の撮像機構であって、

前記回路基板の実装面には、前記実装面と平行な外面を有する電子部品が実装され、

前記回路基板には、前記電子部品を覆い熱伝導性を有する絶縁性のカバーが固定され、

前記電子部品の前記外面と前記カバーとの間には、熱伝導性を有する絶縁性の熱伝導シートが介在されている

ことを特徴とする撮像機構。

【請求項 6】

請求項 5 に記載の撮像機構であって、

前記カバーは、前記実装面に垂直な軸線回りに測った長さが、前記実装面に近い側の端における前記長さよりも、前記実装面から遠い側の端における前記長さの方が短いことを特徴とする撮像機構。

【請求項 7】

請求項 1 に記載の撮像機構であって、

前記保持部材は、当該保持部材の外面のうち前記センサ接触面と交差するリード接触面を有し、

前記入出力用リードは、前記センサ面から前記センサ接触面方向へ突出し前記リード接触面方向へ曲げられて前記リード接触面へ向かって延びており、

前記リード接触面上には、前記入出力用リードのピッチに対応して配され前記入出力用リードが電氣的且つ機械的に接続される導体パターンが形成されている

ことを特徴とする撮像機構。

10

【請求項 8】

先端と基端とを有する長尺の挿入部と、

前記挿入部の先端に配され観察対象物を撮像するための請求項 1 から請求項 7 のいずれか一項に記載の撮像機構と、

前記挿入部の基端に設けられた操作部と、

を備えることを特徴とする内視鏡装置。

20

【請求項 9】

先端と基端とを有する長尺の挿入部と、

前記挿入部の先端に配され観察対象物を撮像するための請求項 5 または請求項 6 に記載の撮像機構と、

前記挿入部の基端に設けられた本体部と、

を備え、

前記挿入部の内部には、先端が前記カバーに熱的に接続された金属線が設けられていることを特徴とする内視鏡装置。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

30

本発明は、撮像機構及び内視鏡装置に関する。

【背景技術】

【0002】

従来、観察対象物の内部等を観察する際に、内視鏡装置を観察対象物の内部等に挿入して観察することが知られている。内視鏡装置としては、例えば遠位端と近位端とを有する長尺の挿入部を備え、挿入部の遠位端に対象物を撮像するための撮像機構が配置されたものが知られている。

【0003】

このような撮像機構の例として、たとえば特許文献 1 には、電子内視鏡の先端部が開示されている。特許文献 1 に記載の電子内視鏡は、先端部において、固体撮像素子（イメージセンサ）が実装された基板とイメージセンサに電氣的に接続された信号線とが樹脂塊内に封止されている。

40

特許文献 1 に記載の電子内視鏡の先端部において、上記樹脂塊は硬質であるので、樹脂塊が設けられた部分は、柔軟性に乏しい硬質部となっている。ここで、イメージセンサに電氣的に接続された信号線の先端から各信号線が一束となる部分までの間も上記硬質部となっている。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0004】

【特許文献 1】特開 2006 - 68058 号公報

50

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0005】

近年、受光素子数が多いイメージセンサが知られている。このようなイメージセンサは、多数の受光素子が整列して形成されたセンサ面を有しており、センサ面の面積を大きく取って受光素子数を増やしたものや、受光素子の集積度を上げ受光素子ピッチを小さくすることにより受光素子数を増やしたものなどが知られている。ここで、受光素子ピッチが小さすぎると、受光素子数を多くしてもイメージセンサによって得られた画像の画質を向上させにくいという問題があり、高画質の画像を撮像するイメージセンサは、センサ面の面積が大きくなる傾向がある。

10

【0006】

また、内視鏡装置には、細い隙間等に挿入しやすい細径で柔軟な挿入部が求められている。しかしながら、従来の内視鏡装置は、挿入部に搭載可能なイメージセンサを高画質で大型なものとしようとすると、イメージセンサに接続する信号線等を含む硬質部の寸法も大きくなり、挿入部が大径となったり挿入部の硬質部の長さが長くなったりするという課題を抱えている。

【0007】

本発明は、上述した事情に鑑みてなされたものであって、その目的は、高画質のイメージセンサを搭載しても挿入部の大型化を抑えることができる撮像機構及び内視鏡装置を提供することである。

20

【課題を解決するための手段】

【0008】

上記課題を解決するために、この発明は以下の手段を提案している。

本発明の撮像機構は、複数の受光素子が配されたセンサ面と複数の入出力用リードとを有するイメージセンサと、前記イメージセンサにおいて前記センサ面が設けられた側とは反対側の面に接するセンサ接触面を有する保持部材と、前記保持部材における前記センサ接触面と反対側の外面に固定され、前記センサ面と平行な実装面を有し、前記実装面に垂直な方向から見たときに輪郭線の少なくとも一部が前記保持部材の輪郭線の内側に位置する回路基板と、前記回路基板において前記実装面と交差して形成された側面上であって前記回路基板の輪郭線が前記保持部材の輪郭線の内側に位置している領域内に配された接点部と、を備え、前記保持部材と前記回路基板との少なくともいずれかは、前記接点部が電氣的に接続されているとともに前記入出力用リードの少なくとも一つが電氣的に接続された中継配線部を有していることを特徴とする撮像機構である。

30

【0009】

また、前記接点部には、前記イメージセンサに対して電力若しくは電気信号を伝送するための第一配線が接続され、前記側面のうち前記接点部が配された面とは異なる面上には、前記入出力用リードの少なくとも他の一つが接続され且つ前記イメージセンサに対して電力若しくは電気信号を伝送するための第二配線が接続される第二接点部が設けられており、前記第一配線のうちの少なくとも一つは前記第二配線よりも外径が太いことが好ましい。

40

【0010】

また、前記側面のうち前記接点部が配された面とは異なる面上には、前記入出力用リードの少なくとも他の一つが接続され且つ前記イメージセンサに対して電力若しくは電気信号を伝送するための第二配線が接続される第二接点部が設けられており、前記領域内には、前記接点部と異なる第三接点部が配され、前記第三接点部は、前記回路基板に設けられた導体パターンと接続され、前記回路基板上に実装された電子部品と電氣的に接続され、前記第三接点部には、前記電子部品と前記イメージセンサとの少なくともいずれかに対して電力若しくは電気信号を伝送するための第三配線が電氣的且つ機械的に接続されることが好ましい。

【0011】

50

また、前記第三接点部は１つ以上設けられており、前記第三接点部に接続された前記第三配線のうちの少なくとも一つは前記第二配線よりも外径が太いことが好ましい。

【００１２】

また、前記回路基板の実装面には、前記実装面と平行な外面を有する電子部品が実装され、前記回路基板には、前記電子部品を覆い熱伝導性を有する絶縁性のカバーが固定され、前記電子部品の前記外面と前記カバーとの間には、熱伝導性を有する絶縁性の熱伝導シートが介在されていることが好ましい。

【００１３】

また、前記カバーは、前記実装面に垂直な軸線回りに測った長さが、前記実装面に近い側の端における前記長さよりも、前記実装面から遠い側の端における前記長さの方が短いことが好ましい。

10

【００１４】

また、前記保持部材は、当該保持部材の外面のうち前記センサ接触面と交差するリード接触面を有し、前記入出力用リードは、前記センサ面から前記センサ接触面方向へ突出し前記リード接触面方向へ曲げられて前記リード接触面へ向かって延びており、前記リード接触面上には、前記入出力用リードのピッチに対応して配され前記入出力用リードが電氣的且つ機械的に接続される導体パターンが形成されていることが好ましい。

【００１５】

本発明の内視鏡装置は、先端と基端とを有する長尺の挿入部と、前記挿入部の先端に配され観察対象物を撮像するための上記撮像機構と、前記挿入部の基端に設けられた操作部と、を備えることを特徴とする内視鏡装置である。

20

【００１６】

また、本発明の内視鏡装置は、先端と基端とを有する長尺の挿入部と、前記挿入部の先端に配され観察対象物を撮像するための上記撮像機構と、前記挿入部の基端に設けられた本体部と、を備え、前記挿入部の内部には、先端が前記カバーに熱的に接続された金属線が設けられていることを特徴とする内視鏡装置である。

【発明の効果】

【００１７】

本発明の撮像機構及び内視鏡装置によれば、高画質のイメージセンサを搭載しても挿入部の大型化を抑えることができる。

30

【図面の簡単な説明】

【００１８】

【図１】本発明の一実施形態の内視鏡装置を示す全体図である。

【図２】同内視鏡装置における挿入部の先端部分の断面図である。

【図３】同内視鏡装置に設けられた撮像機構の斜視図である。

【図４】同撮像機構の断面図である。

【図５】同撮像機構を基端から先端へ向かって見た図である。

【図６】同撮像機構を先端から基端へ向かって見た図である。

【発明を実施するための形態】

【００１９】

40

本発明の一実施形態の撮像機構８及び内視鏡装置１について説明する。図１は、本実施形態の内視鏡装置１を示す全体図である。図２は、内視鏡装置１における挿入部２の先端部分の断面図である。図３は、内視鏡装置１に設けられた撮像機構８の斜視図である。図４は、撮像機構８の断面図である。図５は、同撮像機構８を基端から先端へ向かって見た図である。図６は、撮像機構８を先端から基端へ向かって見た図である。

【００２０】

図１に示すように、内視鏡装置１は、観察対象物の内部等に先端から挿入される長尺の挿入部２と、挿入部２の基端に設けられた操作部４０と、操作部４０とケーブルによって電氣的に接続された本体部５０とを備える。

【００２１】

50

図 1 及び図 2 に示すように、挿入部 2 は、可撓性を有する可撓管部 3 と、可撓管部 3 の先端に配された湾曲部 5 と、湾曲部 5 の先端に配された先端構成部 7 とを備える。

【0022】

図 2 に示すように、可撓管部 3 は、中空構造を有し径方向断面が円形をなす筒状部材である。可撓管部 3 の内部には、湾曲部 5 を湾曲させるためのアングルワイヤ W と、先端構成部 7 に設けられた後述する撮像機構 8 及び照明機構 26 に対して電力及び電気信号を送送するための配線部 4 とが配されている。

【0023】

湾曲部 5 は、湾曲可能な筒状形状を有し、直線状となっていたときには可撓管部 3 と同軸をなすように可撓管部 3 に固定されている。湾曲部 5 は、その中心軸線方向に複数の節輪または湾曲駒（以下、「節輪等 6」と称する。）が並べて設けられている。複数の節輪等 6 は、隣接する節輪等 6 が互いに連結されている。湾曲部 5 において最も先端側に配された節輪等 6 には、上述のアングルワイヤ W の先端が連結されており、アングルワイヤ W が基端方向へと移動されることによって、湾曲部 5 が湾曲動作される。

【0024】

先端構成部 7 は、撮像機構 8 と、撮像機構 8 へと外光を導く撮像光学系 24 と、観察対象物に対して照明光を照射する照明機構 26 とを備える。また、先端構成部 7 は、交換可能なキャップ状の光学アダプタ 30 を備える。

【0025】

図 2 及び図 3 に示すように、撮像機構 8 は、観察対象物の像を撮像するために設けられており、イメージセンサ 9 と、保持部材 14 と、回路基板 17 と、カバー 22 とを備える。

【0026】

イメージセンサ 9 は、複数の受光素子が整列配置されたセンサ面 10 及びセンサ面 10 の各受光素子から信号を読み出して出力する信号処理回路（不図示）が形成されたセンサ本体 11 と、信号処理回路に対して入出力を行うための入出力用リード 12 とを備える。

本実施形態では、センサ本体 11 は、センサ面 10 に直交する方向から見たときに矩形形状をなす板状となっている。また、センサ面 10 に直交する方向から見たときに、センサ本体 11 における対向する一組の辺のそれぞれからは、複数の上記入出力用リード 12 が延びている。また、センサ面 10 は、縦横比が 4 : 3 や 16 : 9 など所定の比となる矩形形状を有している。

本明細書では、センサ面 10 に直交する方向から見たときのセンサ本体 11 の輪郭形状が長方形をなしている場合を例に説明する。なお、センサ本体 11 の形状は、これに限られるものではない。

本実施形態では、イメージセンサ 9 の入出力用リード 12 は、センサ面 10 から保持部材 14 のセンサ接触面 14a 方向へ突出し、リード接触面 14c 方向へ曲げられてリード接触面 14c へ向かって延びている。入出力用リード 12 は、センサ本体 11 からの突出方向を 0 度として、基端側へ 90 度以上曲げられている。各入出力用リード 12 は、後述する回路基板 17 に接する。また、入出力用リード 12 とセンサ本体 11 との間には、入出力用リード 12 とセンサ本体 11 との絶縁状態を保つための絶縁部材 13 が介在されている。

【0027】

図 3 及び図 4 に示すように、保持部材 14 は、イメージセンサ 9 においてセンサ面 10 が設けられた側とは反対側の面が接するセンサ接触面 14a を有する絶縁性部材である。また、保持部材 14 には、イメージセンサ 9 の動作時にイメージセンサ 9 から発せられる熱の放熱経路となる導体パターン（不図示）が形成されている。

保持部材 14 の形状は、センサ接触面 14a が底面となる枡状形状である。すなわち、保持部材 14 は、センサ接触面 14a が設けられた側が封止され、センサ接触面 14a が設けられた側と反対側が開口された容器形状をなしている。センサ接触面 14a は、イメージセンサ 9 のセンサ面 10 と直交する方向から見たときにセンサ本体 11 の輪郭線より

10

20

30

40

50

も小さな長方形に形成されている。また、保持部材 14 の外側輪郭線の形状は、略直方体形状となっている。

保持部材 14 の内部には、イメージセンサ 9 によって撮像された画像の後述する制御部 52 への出力を制御するための電子部品の一部と、各電子部品を絶縁する絶縁板 15 とが配置されている。保持部材 14 の内部において、動作時の発熱が小さな部品は保持部材 14 の底面側（先端構成部 7 における先端側）に配され、動作時の発熱が大きな部品は保持部材 14 の開口側（先端構成部 7 における基端側）に配されている。これにより、各電子部品の発熱によるイメージセンサ 9 への影響を低く抑えることができる。

保持部材 14 の開口の周囲は、後述する回路基板 17 と接する基板接触面 14b となっている。基板接触面 14b には、イメージセンサ 9 のリードと後述する回路基板 17 の端子とを電氣的に接続する中継配線部 16 が形成されている。

【0028】

図 3 及び図 5 に示すように、中継配線部 16 は、保持部材 14 の外面に形成された薄板若しくは膜状の金属部材である。中継配線部 16 は、保持部材 14 の開口の四隅にそれぞれ配されている。各中継配線部 16 は、イメージセンサ 9 の入出力用リード 12 のうち、イメージセンサ 9 の四隅から延びる 4 つの隅部リード 12a がそれぞれ接続されるようになっている。

中継配線部 16 と隅部リード 12a とは、半田付けによって電氣的かつ機械的に固定されている。

【0029】

また、図 3 及び図 4 に示すように、保持部材 14 は、保持部材 14 の外面のうちセンサ接触面 14a と交差するリード接触面 14c を有している。リード接触面 14c には、イメージセンサ 9 に設けられた複数の入出力用リード 12 のピッチに対応して配された複数の導体パターン 14d が形成されている。

【0030】

本実施形態では、導体パターン 14d は、センサ接触面 14a に直交する方向に長い矩形形状を有している。各導体パターン 14d の長手方向の中間部において、導体パターン 14d と入出力用リード 12 とが半田付けにより電氣的且つ機械的に接続されている。なお、図 3 及び図 4 においては導体パターン 14d と入出力用リード 12 とを接続する半田の図示が省略されている。

【0031】

図 3 ないし図 5 に示すように、回路基板 17 は、イメージセンサ 9 のセンサ面 10 と平行に実装面 17a、17b が向けられた板状部材である。回路基板 17 には、イメージセンサ 9 の動作を制御するためのカメラコントロールユニットの一部が配置されている。

図 4 に示すように、本実施形態では、回路基板 17 は、厚さ方向の両面が実装面（実装面 17a、17b）とされており、回路基板 17 に実装される電子部品のうち、相対的に発熱量が多い電子部品は、保持部材 14 の開口に接する実装面 17a とは反対側の実装面 17b 上に実装されている。

【0032】

図 5 に示すように、回路基板 17 の寸法は、実装面 17a、17b と直交する方向（図 4 に符号 X で示す方向）から見たときの輪郭形状が略正方形となっており、一辺の長さは、保持部材 14 をセンサ接触面 14a と直交する方向から見たときの短辺の長さとは略一致する長さとなっている。回路基板 17 の外面のうち、二つの実装面 17a、17b と交差する面（以下、この面を「側面 17c」と称する。）には、中継配線部 16 が接続される接点部 18 と、イメージセンサ 9 の入出力用リード 12 が接続される第二接点部 19 と、配線部 4 における後述する信号線 4a 及び撮像側電力線 4b が接続される第三接点部 20 とが設けられている。

【0033】

接点部 18 は、実装面 17a、17b と直交する方向（図 4 に符号 X で示す方向）から見たときに、回路基板 17 の側面 17c のうち保持部材 14 の輪郭線の内側領域に位置す

10

20

30

40

50

る側面に設けられている。接点部 18 は、上記信号線 4 a 若しくは撮像側電力線 4 b が入り込む溝を有する凹形状の金属薄膜によって構成されている。接点部 18 と中継配線部 16 とは、半田付け等によって電氣的かつ機械的に接続されている。なお、接点部 18 は、必要に応じて、回路基板 17 の内部に設けられた図示しない内部配線を介して、回路基板 17 上に実装された各電子回路（例えば電子部品 21）や、保持部材 14 内に配された電子部品等に電氣的に接続されていてもよい。

【0034】

第二接点部 19 は、イメージセンサ 9 の入出力用リード 12 の位置に対応した位置に設けられており、入出力用リード 12 が入り込む溝を有する凹形状の金属薄膜によって構成されている。第二接点部 19 は、入出力用リード 12 が直接半田付け等によって電氣的かつ機械的に接続される。また、第二接点部 19 は、必要に応じて、回路基板 17 の内部に設けられた図示しない上記内部配線と接続される。なお、回路基板 17 内部に設けられた内部配線は、例えば金属の薄膜からなる導体パターンによって形成される。また、第二接点部 19 の少なくとも一部は、回路基板 17 の内部配線や回路基板 17 上に実装される電子部品（例えば電子部品 21）との電氣的な接続がされないダミーパッドであってもよい。

10

【0035】

第三接点部 20 は、実装面 17 a、17 b と直交する方向（図 4 に符号 X で示す方向）から見たときに、回路基板 17 の側面 17 c のうち保持部材 14 の上記輪郭線の内側領域に位置する側面に設けられ、2 つの接点部 18 の間に配置されている。第三接点部 20 は、回路基板 17 の内部に設けられた図示しない内部配線を介して、回路基板 17 上に実装された各電子回路（例えば電子部品 21）に電氣的に接続されている。

20

【0036】

図 3 ないし図 5 に示すように、カバー 22 は、回路基板 17 の実装面 17 b に実装された電子部品 21 を外力から保護するための部材であり、かつ、これらの電子部品 21 から発せられた熱を放熱するための経路となる部材である。カバー 22 は、回路基板 17 の実装面 17 b の外周部分に沿うように回路基板 17 の実装面 17 b に固定されている。カバー 22 の材料は、たとえばセラミックスなど、外力を受けても変形しにくい材料であることが好ましい。

【0037】

カバー 22 の形状は、実装面 17 a、17 b に垂直な軸線回りに測った長さが、実装面 17 a、17 b に近い側の端における長さよりも、実装面 17 a、17 b から遠い側の端における長さの方が短い。すなわち、本実施形態では、カバー 22 は、先端構成部 7 の基端側に行くに従って漸次径が小さくなるように形成されている。カバー 22 の外面には、配線部 4 を構成する線の一部（例えば信号線 4 a 及び撮像側電力線 4 b）が配置されている。配線部 4 は、カバー 22 の外面に沿って基端側へと延び、カバー 22 よりも基端側において束ねられている。

30

本実施形態では、カバー 22 は、実装面 17 b に接する面を底面とする角錐台状に形成されており、側面の一部が開口されている。

【0038】

また、カバー 22 は、電子部品 21 に密着する熱伝導性の高い熱伝導シート 23 を有している。カバー 22 が回路基板 17 に固定されている状態で、熱伝導シート 23 は、電子部品 21 とカバー 22 の内面との双方に押し付けられている。カバー 22 及び熱伝導シート 23 は、絶縁性の材料によって形成されている。また、熱伝導シート 23 は、弾性を有していることが好ましい。

40

【0039】

図 2 に示すように、カバー 22 の外面には、回路基板 17 上に実装された電子部品 21 から発せられた熱を放熱するための金属線 C の先端が熱的に接続されている。金属線 C は、金属の編み線や撚り線によって形成されている。

なお、金属線 C として、配線部 4（信号線 4 a 及び撮像側電力線 4 b）の一部を用いる

50

こともできる。例えば、信号線 4 a にノイズ低減用のシールド線がある場合、当該シールド線を用いてカバー 2 2 からの熱の拡散をさせることができる。

【 0 0 4 0 】

撮像機構 8 に接続される配線部 4 (信号線 4 a 及び撮像側電力線 4 b) は、イメージセンサ 9 の入出力用リード 1 2 と直結する必要がない線が、第三接点部 2 0 に接続される。また、第三接点部 2 0 に配される信号線 4 a 及び撮像側電力線 4 b は、これらの外径に基づいて優先順位がつけられて選択されている。すなわち、第三接点部 2 0 に配される信号線 4 a 及び撮像側電力線 4 b は、最も外径が太い線から順に選択され第三接点部 2 0 に接続される。また、第三接点部 2 0 に接続される線に対応させて、回路基板 1 7 の内部配線の構成が決定される。第三接点部 2 0 に接続される線の外径は、芯線、被覆、及びシールド等の各構成要素の外径によって定まっている。たとえば、撮像機構 8 によって撮像された画像の信号を伝送するための信号線 4 a は、信号にノイズが混入するのを防止する目的で、芯線がシールドに覆われている場合があり、芯線と被覆のみからなる他の信号線 4 a と比較して外径が太くなる傾向がある。このため、信号線 4 a は、特に第三接点部 2 0 に接続されるのが好ましい。

10

【 0 0 4 1 】

第三接点部 2 0 において、第三接点部 2 0 に接続される信号線 4 a 及び撮像側電力線 4 b は、回路基板 1 7 の実装面 1 7 a、1 7 b に垂直な方向から見たときにイメージセンサ 9 の輪郭線からはみ出さないようになっている。第二接点部 1 9 及び接点部 1 8 においても同様に、回路基板 1 7 の実装面 1 7 a、1 7 b に垂直な方向から見たときにイメージセンサ 9 の輪郭線から信号線 4 a 及び撮像側電力線 4 b がはみ出さないようになっている。

20

【 0 0 4 2 】

撮像機構 8 に接続される信号線 4 a 及び撮像側電力線 4 b は、カバー 2 2 の外面に沿って可撓管部 3 側へと延びており、一束にまとめられた状態で可撓管部 3 内に挿入されている。回路基板 1 7 の実装面 1 7 a、1 7 b に垂直な方向から見たときに、撮像機構 8 に接続される信号線 4 a 及び撮像側電力線 4 b は、イメージセンサ 9 の輪郭線の内側領域に収まっている。撮像機構 8 に接続される信号線 4 a 及び撮像側電力線 4 b において、回路基板 1 7 から上記一束にまとめられた部分までの間では、各線は接着剤等によって固定されており、外力によって各線が回路基板 1 7 から外れたり各線が断線したりしないようになっている。

30

【 0 0 4 3 】

図 2 に示すように、撮像光学系 2 4 は、イメージセンサ 9 のセンサ面 1 0 の中央を通りセンサ面 1 0 と直交するように光軸が位置決めされた光学系である。撮像光学系 2 4 の構成は特に限定されるものではなく、ズーム機構等を備えていてもよい。また、撮像光学系 2 4 には、光学特性を変更するための追加的な対物光学系 2 5 を組み合わせることもできる。例えば、本実施形態では、追加的な対物光学系 2 5 が光学アダプタ 3 0 に設けられている。

【 0 0 4 4 】

照明機構 2 6 は、光学アダプタ 3 0 内に設けられた光源 2 7 と、光源 2 7 から発せられる光の配光を制御するために光学アダプタ 3 0 に設けられた照明光学系 2 8 と、光源 2 7 に電力を供給する照明電力線 2 9 とを有する。光源 2 7 としては、たとえば発光ダイオード等を使用することができる。照明電力線 2 9 は、可撓管部 3 の内部を通じて操作部 4 0 の内部へと延び、後述する制御部 5 2 に接続されている。

40

【 0 0 4 5 】

図 1 に示すように、操作部 4 0 には、湾曲部 5 を湾曲させるために使用者が湾曲方向を入力するためのジョイスティック 4 1 が設けられている。本実施形態の内視鏡装置 1 では、ジョイスティック 4 1 は所定の中立位置に対して傾けられた方向が湾曲部 5 を湾曲させる方向として本体部 5 0 に入力される。本体では、ジョイスティック 4 1 からの入力に基づいて、湾曲部 5 を湾曲動作させる。

【 0 0 4 6 】

50

本体部 50 は、表示部 51 と、制御部 52 と、電源部 53 とを備える。

表示部 51 は、撮像機構 8 によって撮像された画像を表示する装置であり、たとえば液晶表示パネル及び表示制御回路を有している。

【0047】

制御部 52 は、上述の撮像機構 8、照明機構 26、及び表示部 51 の動作を制御するための各種電子部品を備える。

【0048】

電源部 53 は、上述の撮像機構 8、照明機構 26、表示部 51、及び制御部 52 を駆動させるための電力を供給するものであり、本実施形態では、バッテリーと、電力制御回路とを本体部 50 内に備えている。なお、バッテリー及び電力制御回路を本体部 50 内に備えることに代えて、若しくはバッテリー及び電力制御回路に加えて、商用電源を用いて内視鏡装置 1 を駆動させるための電源ユニットを本体内に備えていてもよい。

【0049】

次に、本実施形態の撮像機構 8 及び内視鏡装置 1 の作用について説明する。

内視鏡装置 1 の挿入部 2 は、観察対象物の内部等に挿入されるものであり、小径であることが好ましい。このため、挿入部 2 の内部構造物を収容するための空間は限られている。たとえば、先端構成部 7 においては、限られた空間内に、撮像機構 8 と照明機構 26 とをともに収容する必要がある。また、先端構成部 7 は、撮像機構 8 と照明機構 26 とを外力から保護する目的で硬質となっている。ここで、先端構成部 7 の中心軸線方向の長さが長いと、狭い領域で曲率半径が小さく湾曲したような観察対象物になるほど、挿入部 2 の先端が曲がらずに突っかかるようになり、挿入部 2 の先端を案内するのが困難である。また、本実施形態では、撮像機構 8 の信号線 4a 及び撮像側電力線 4b が互いに固定された部分も、柔軟性が乏しい部分であり、これらの硬質な構成部分により、挿入部 2 の先端部分には硬質部が生じる。

【0050】

図 3 及び図 6 に示すように、本実施形態では、撮像機構 8 の信号線 4a 及び撮像側電力線 4b のうち外径が太い線（例えば図 6 に示す信号線 4x、4y）が、優先的に第三接点部 20 に接続されており、先端構成部 7 の中心軸線方向から見たときにイメージセンサ 9 の輪郭線の内側に配置されている。

さらに、外径が太い線が、回路基板 17 の厚さ方向から見たときの回路基板 17 の中心に近い位置にあるので、当該太い線を他の線と一束にまとめるときに、撮像機構 8 の信号線 4a 及び撮像側電力線 4b が互いに固定された部分の先端構成部 7 の中心軸線方向における長さを短くしても、当該太い線を曲げる量は少なくてもよい。その結果、当該太い線を曲げることによる当該太い線への負荷が少ない状態で、硬質部の長さを短くすることができる。

【0051】

また、イメージセンサ 9 の受光素子数が多い場合には、イメージセンサの受光素子数が少ない場合と比較して、信号線 4a を流れる信号が高周波となり、信号に対するノイズの影響が大きくなりやすい。このため、このようなイメージセンサ 9 を使用する場合には、信号線 4a にシールドを設けたり、各信号線 4a とグランド線とをツイストペア構成としたりするなど、信号線 4a の外径が太くなりやすい。また、イメージセンサ 9 の受光素子数が多い場合には、イメージセンサ 9 が大型となる傾向がある。この場合、イメージセンサ 9 のセンサ面 10 に垂直な方向から見たときにイメージセンサ 9 の輪郭線から信号線 4a がはみ出すと、先端構成部 7 が大径になってしまうおそれがある。

【0052】

これに対して、図 6 に示すように、本実施形態の撮像機構 8 は、イメージセンサ 9 のセンサ面 10 と直交する方向、すなわち先端構成部 7 の中心軸線方向から見たときに、信号線 4a 及び撮像側電力線 4b は、イメージセンサ 9 の輪郭線の内側に収まっている。このため、イメージセンサ 9 のセンサ面 10 に垂直な方向から見たときの撮像機構 8 の寸法はイメージセンサ 9 の寸法によって規定されることとなる。このため、撮像機構 8 に接続さ

れる信号線 4 a 及び撮像側電力線 4 b がイメージセンサ 9 の輪郭線からはみ出すことによる先端構成部 7 の大径化が防止される。

【 0 0 5 3 】

また、撮像機構 8 の動作時には、イメージセンサ 9 その他の電子部品から発せられる熱により、イメージセンサ 9 に対する暗電流に起因する熱ノイズが生じる場合がある。本実施形態では、イメージセンサ 9 から発せられた熱は、図 4 に示す保持部材 1 4、回路基板 1 7、熱伝導シート 2 3、及びカバー 2 2 を通じて金属線 C (図 2 参照) へと拡散する。これにより、イメージセンサ 9 の温度が上昇することによって画像に生じるノイズを低減させることができる。特に、イメージセンサ 9 上に構成される受光素子数が多くなったり、信号処理回路の動作周波数が高くなったりすると、イメージセンサ 9 の発熱量は大きくなる。

10

本実施形態では、挿入部 2 の先端から基端へ向かって直線的に放熱経路が設けられていることにより、挿入部 2 の先端に配されたイメージセンサ 9 その他の電子部品の熱が挿入部 2 の先端側にこもるのを低減することができる。これにより、イメージセンサ 9 によって撮像された画像の画質の低下を抑制することができる。

【 0 0 5 4 】

以上説明したように、本実施形態の撮像機構 8 及び内視鏡装置 1 によれば、挿入部 2 の硬質部の長さが長くなるのを抑えつつ、大型のイメージセンサ 9 を搭載することができる。その結果、高画質のイメージセンサ 9 を搭載しても挿入部 2 の大型化を抑えることができる。

20

【 0 0 5 5 】

また、従来と同等のイメージセンサを搭載する場合には、硬質部の長さを短くすることができる。

【 0 0 5 6 】

また、イメージセンサ 9 が発する熱を好適に挿入部 2 の基端側へと移動させる経路を有しているので、イメージセンサ 9 に対する熱ノイズの影響を少なく抑え、画質の高い画像を撮像することができる。

【 0 0 5 7 】

以上、本発明の実施形態について図面を参照して詳述したが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含まれる。

30

例えば、熱伝導シート 2 3 に代えて、熱伝導性の高いグリスが設けられていてもよい。

また、保持部材のセンサ接触面は、イメージセンサのセンサ面と直交する方向から見たときにセンサ本体の輪郭線と一致する長方形状 (略一致する長方形状を含む) とされていてもよい。

また、中継配線部は、基板接触面以外の面に設けられていてもよい。また、中継配線部は、保持部材のリード接触面に形成された導体パターンと接続されていてもよい。

また、中継配線部は、回路基板の側面に形成されていてもよい。

さらに、保持部材と回路基板との両方に中継配線部が形成されていてもよい。この場合、保持部材に形成された中継配線部と回路基板に形成された中継配線部と互いに電氣的に導通した状態で設けられている。

40

【 0 0 5 8 】

なお、本発明の実施形態に対する設計変更等は上記例示には限定されない。

【 符号の説明 】

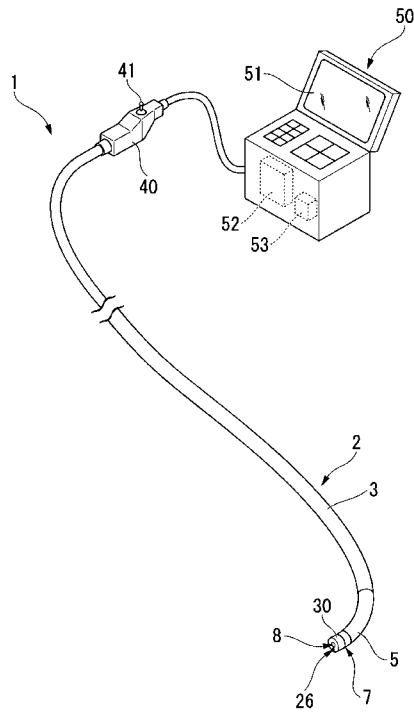
【 0 0 5 9 】

- 1 内視鏡装置
- 2 挿入部
- 3 可撓管部
- 4 配線部
- 4 a 信号線
- 4 b 撮像側電力線

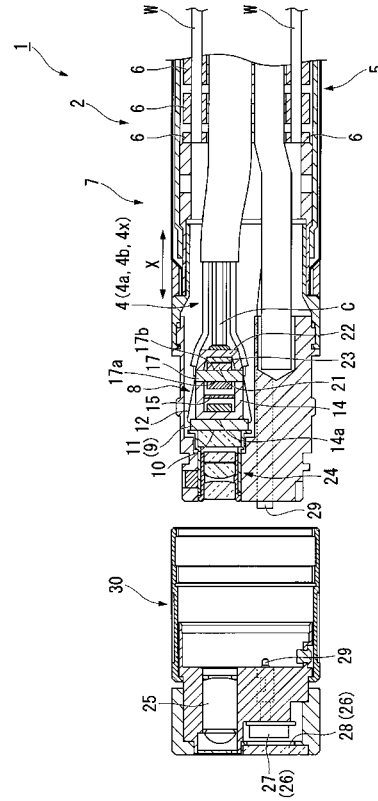
50

4 x	信号線	
5	湾曲部	
6	節輪等	
7	先端構成部	
8	撮像機構	
9	イメージセンサ	
W	アングルワイヤ	
1 0	センサ面	
1 1	センサ本体	
1 2	入出力用リード	10
1 2 a	隅部リード（入出力用リード）	
1 3	絶縁部材	
1 4	保持部材	
1 4 a	センサ接触面	
1 4 b	基板接触面	
1 4 c	リード接触面	
1 4 d	導体パターン	
1 5	絶縁板	
1 6	中継配線部	
1 7	回路基板	20
1 7 a	実装面	
1 7 b	実装面	
1 7 c	側面	
1 8	接点部	
1 9	第二接点部	
2 0	第三接点部	
2 1	電子部品	
2 2	カバー	
2 3	熱伝導シート	
2 4	撮像光学系	30
2 5	対物光学系	
2 6	照明機構	
2 7	光源	
2 8	照明光学系	
2 9	照明電力線	
3 0	光学アダプタ	
4 0	操作部	
4 1	ジョイスティック	
5 0	本体部	
5 1	表示部	40
5 2	制御部	
5 3	電源部	

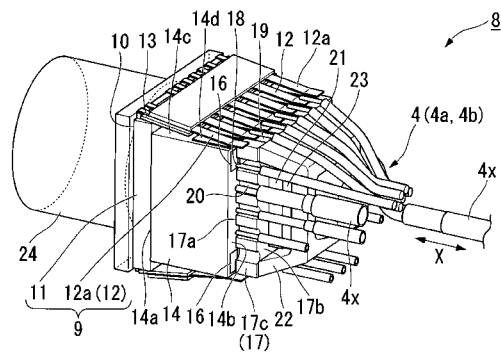
【 図 1 】



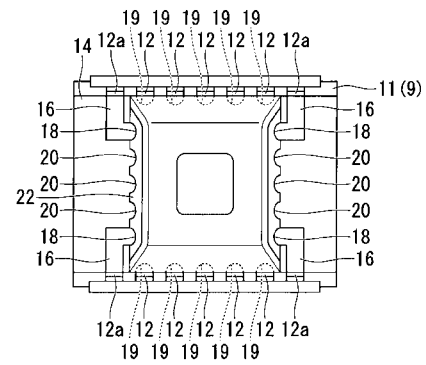
【 図 2 】



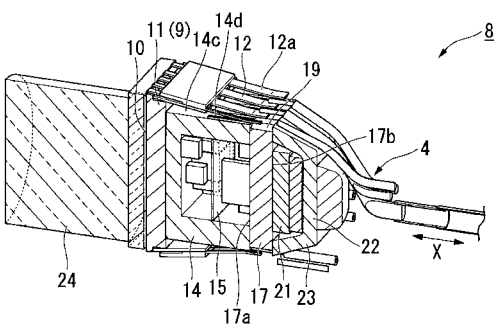
【 図 3 】



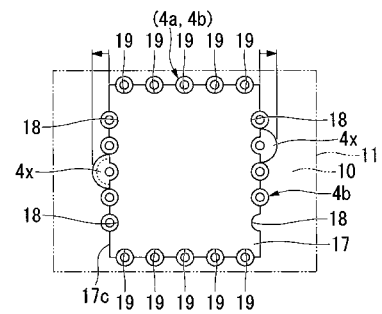
【 図 5 】



【 図 4 】



【 図 6 】



フロントページの続き

(74)代理人 100161702

弁理士 橋本 宏之

(72)発明者 膳 健一

東京都渋谷区幡ヶ谷 2 丁目 4 3 番 2 号 オリンパス株式会社内

F ターム(参考) 2H040 DA12 DA14 DA16 DA18 GA02 GA11

4C161 BB02 CC06 DD03 LL02 NN01 PP15 SS01

5C024 BX02 EX21 EX26

5C122 DA26 EA03 EA54 GE01 GE11 GE18

专利名称(译)	成像机构和内窥镜设备		
公开(公告)号	JP2013135823A	公开(公告)日	2013-07-11
申请号	JP2011289349	申请日	2011-12-28
[标]申请(专利权)人(译)	奥林巴斯株式会社		
申请(专利权)人(译)	奥林巴斯公司		
[标]发明人	膳健一		
发明人	膳 健一		
IPC分类号	A61B1/04 G02B23/24 H04N5/335 H04N5/225		
CPC分类号	H04N5/2251 A61B1/051		
FI分类号	A61B1/04.372 G02B23/24.B G02B23/24.A H04N5/335 H04N5/225.D A61B1/04.530 A61B1/05 A61B1/12.541 H04N5/225 H04N5/225.100 H04N5/225.430 H04N5/225.500		
F-TERM分类号	2H040/DA12 2H040/DA14 2H040/DA16 2H040/DA18 2H040/GA02 2H040/GA11 4C161/BB02 4C161/CC06 4C161/DD03 4C161/LL02 4C161/NN01 4C161/PP15 4C161/SS01 5C024/BX02 5C024/EX21 5C024/EX26 5C122/DA26 5C122/EA03 5C122/EA54 5C122/GE01 5C122/GE11 5C122/GE18		
代理人(译)	塔奈澄夫 铃木史朗		
其他公开文献	JP2013135823A5 JP5926955B2		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

一种成像机构和内窥镜设备，包括：图像传感器，包括传感器面和多个输入/输出引线;保持构件，具有传感器接触面;电路板，固定到所述传感器接触面的相对侧的外表面。保持构件到传感器接触面，并且接触点部分设置在电路板的与安装面相交的侧面上，并且在电路板的轮廓在保持构件的轮廓内的区域中。保持构件和电路板中的至少一个包括中继布线部分，接触点部分和至少一个输入/输出引线电连接到该中继布线部分。

